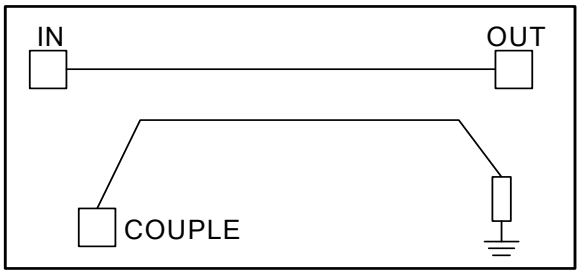
性能特点

- 频率范围：7GHz～13GHz
- 耦合度：22dB
- 耦合度平坦度：6dB
- 插入损耗：0.3dB
- 芯片尺寸：0.75mm×0.8mm×0.10mm

功能框图



产品简介

NC6713C-713一款GaAs MMIC定向耦合器芯片，采用片上平行耦合微带线结构。工作频率覆盖7GHz～13GHz，耦合度19-25dB，插入损耗小于0.3dB，端口驻波小于1.3。

微波电参数（T_A= +25℃，50Ω 系统）

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	f	7～13			GHz
耦合度	C		22		dB
插入损耗	IL	-	0.2	-	dB
输入端口驻波系数	VSWR(in)	-	1.1	-	-
输出端口驻波系数	VSWR(out)	-	1.1	-	-
耦合端口驻波系数	VSWR(co)	-	1.25	-	-
方向性	-	-	19.5	-	dB

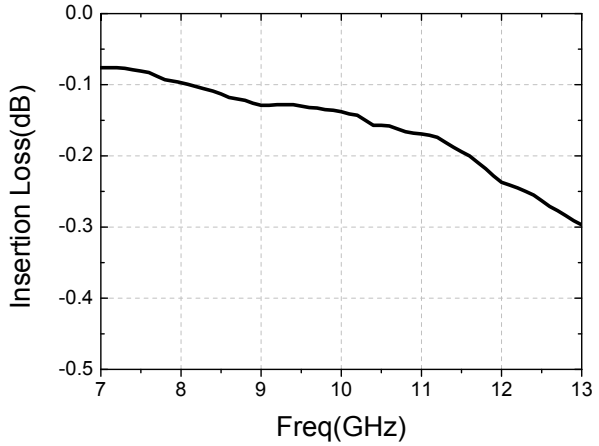
注：芯片均经过在片 100% 微波测试；

使用限制参数

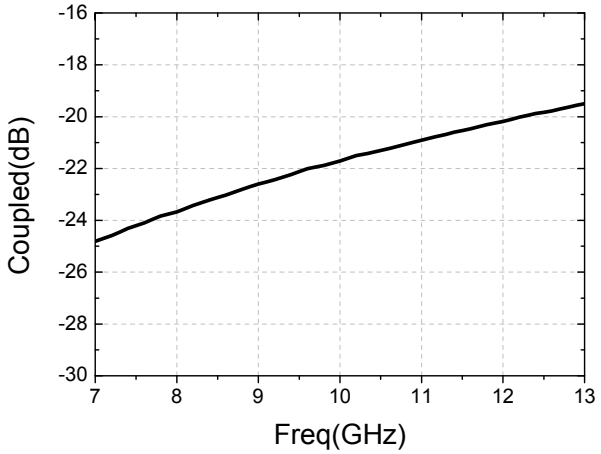
参数	符号	极限值
最高输入功率	P_p	47dBm
工作温度	T_{op}	-55℃～+125℃
储存温度	T_{STG}	-65℃～+150℃

典型曲线

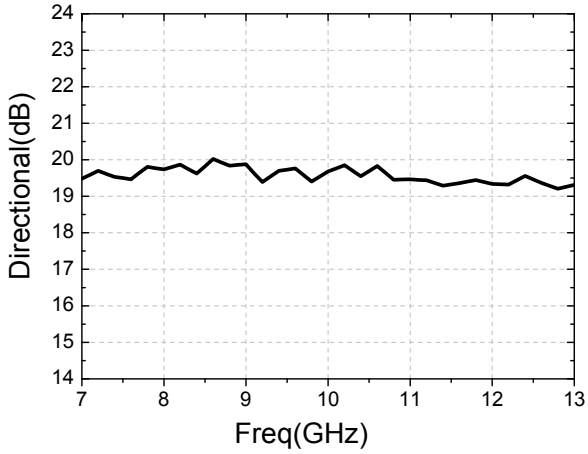
插入损耗 vs.频率



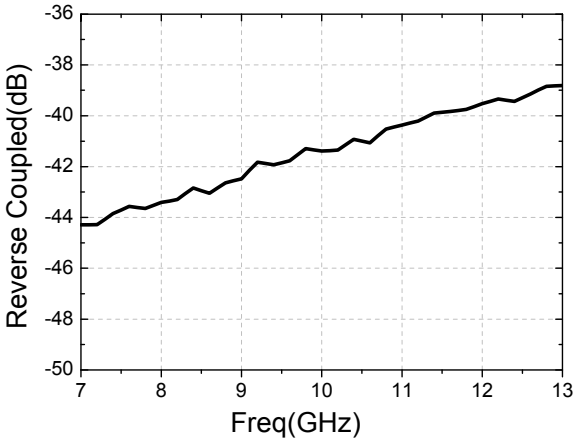
耦合度 vs.频率



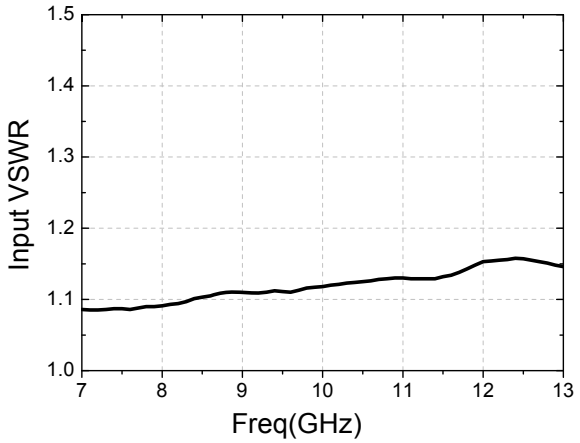
方向性 vs.频率



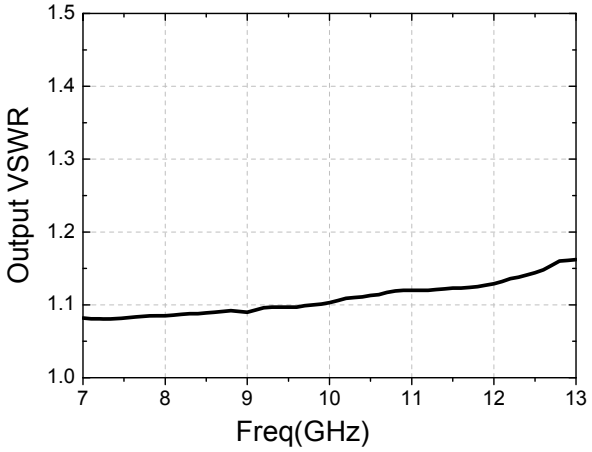
反向耦合度 vs.频率



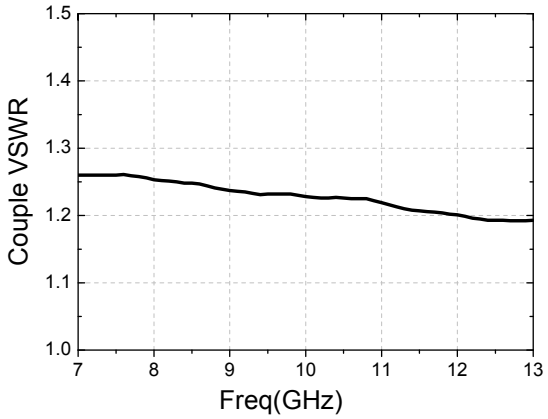
输入驻波系数 vs.频率



输出驻波系数 vs.频率

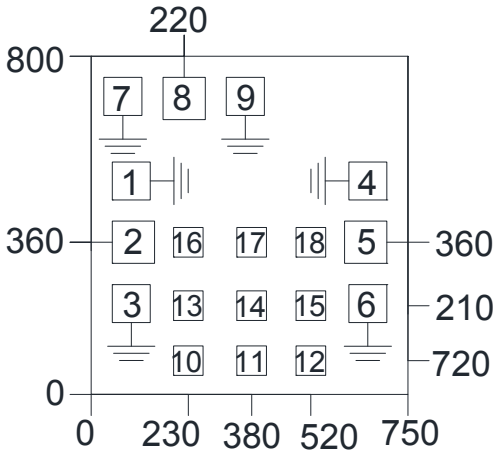


耦合端口驻波系数 vs.频率



外形尺寸及压点排列图

NC6713C-713 外形尺寸

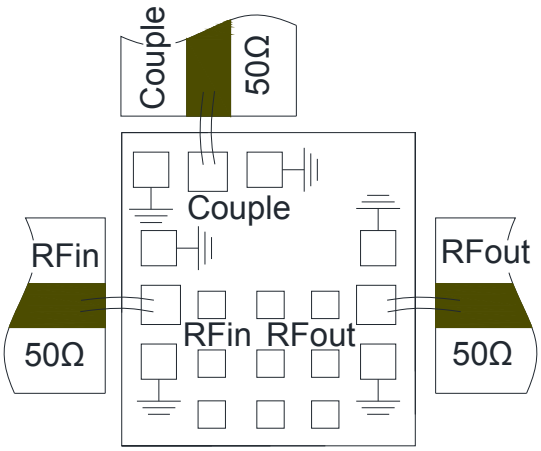


注：图中单位均为微米(μm)；
外形尺寸公差±50μm；
芯片厚度 100μm；
芯片背面接地。

压点排列图

序列号	符号	功能	PAD 尺寸
2	RFin	输入端口	100×100μm^2
5	RFout	输出端口	100×100μm^2
8	Couple	耦合端口	100×100μm^2
1、3、4、6、7、9	GND	探针测试地	90×90μm^2
10、11、12、13、14、15、16、17、18		调节压块	70×70μm^2

建议装配图



注意事项

1) 在净化环境装配使用；
2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要大于 300μm；
4) 芯片背面必须接地；
5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
7) 干燥、氮气环境储存；
8) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面；
9) 有问题请与供货商联系。

该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电